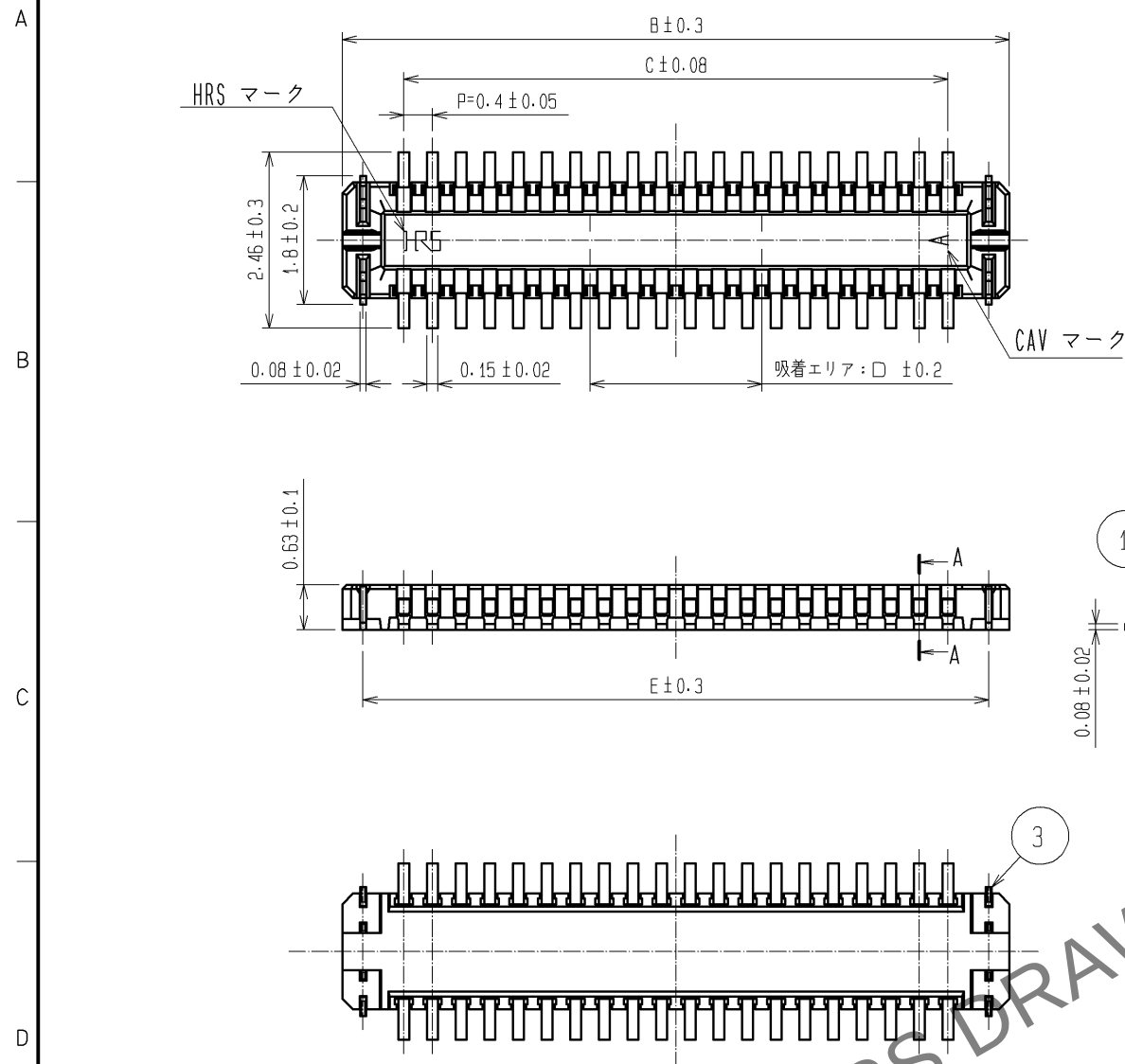
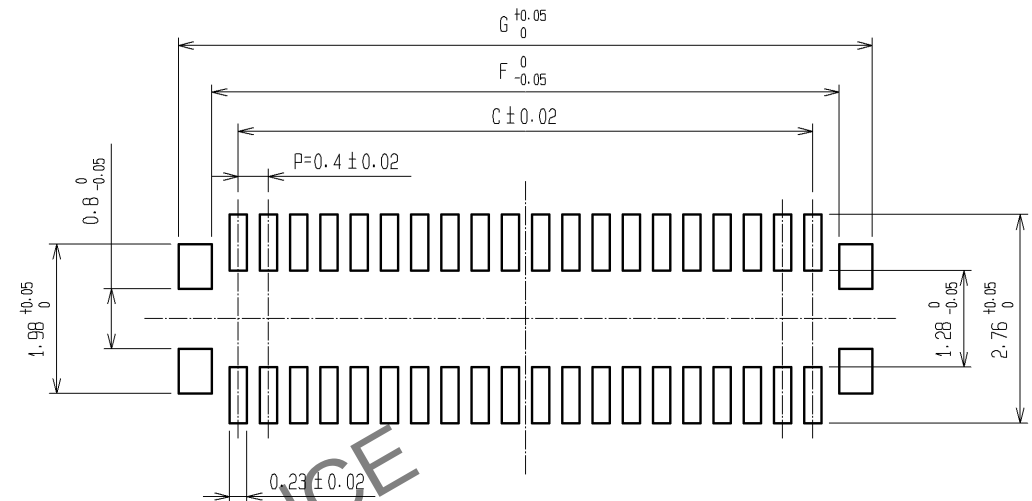


Apr. 1. 2024 Copyright 2024 HIROSE ELECTRIC CO., LTD. All Rights Reserved.
本製品を車載用途などの高い信頼性が求められる機器にご使用の場合は、弊社までお問い合わせ下さい。



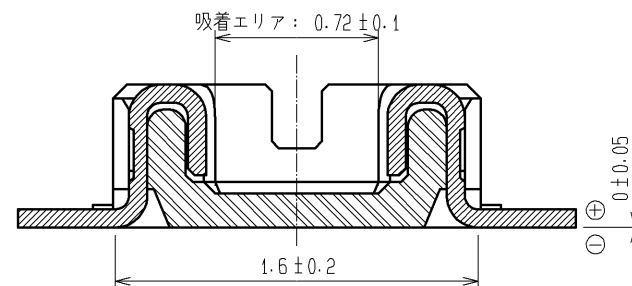
△7 推奨基板パターン図



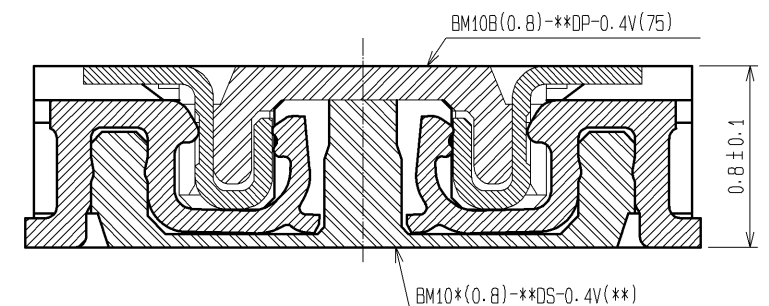
△7 推奨ペースト厚: 120 μ m

△7 推奨メタルマスク開口率: 100%

A-A



嵌合断面図



- 注 1. 平坦度は0.1mm以下とする。
2. 1リール8000個梱包とする。
3. リールの引き出し始め100mm以上と、引き出し
終わり160mm以上は空BOXとする。

△4 端子めっき仕様

接触部 : 金めっき0.1 μ m以上
リード部 : 金めっき0.05 μ m以上
下地 : ニッケルめっき1 μ m以上
(表面 : 封孔処理)

△5 補強金具めっき仕様

実装部: 金めっき0.05 μ m以上
下地 : ニッケルめっき1 μ m以上

6. エンボステープ剥離強度は JIS C 0806 を適用。

△4△7 弊社推奨と異なる設定をする場合は、弊社にお問い合わせ下さい。

PART No.	CODE No.	B	C	D	E	F	G
BM10B(0.8)-10DP-0.4V(75)	CL684-6007-5-75	3.32	1.6	0.8	2.74	2.3	3.18
BM10B(0.8)-15DP-0.4V(75)	CL684-6047-0-75	4.52	2.8	1.6	3.94	3.5	4.38
BM10B(0.8)-20DP-0.4V(75)	CL684-6009-0-75	5.32	3.6	1.6	4.74	4.3	5.18
BM10B(0.8)-24DP-0.4V(75)	CL684-6011-2-75	6.12	4.4	2.0	5.54	5.1	5.98
BM10B(0.8)-30DP-0.4V(75)	CL684-6013-8-75	7.32	5.6	2.0	6.74	6.3	7.18
BM10B(0.8)-34DP-0.4V(75)	CL684-6015-3-75	8.12	6.4	2.4	7.54	7.1	7.98
BM10B(0.8)-40DP-0.4V(75)	CL684-6003-4-75	9.32	7.6	2.4	8.74	8.3	9.18
BM10B(0.8)-44DP-0.4V(75)	CL684-6039-1-75	10.12	8.4	2.8	9.54	9.1	9.98
BM10B(0.8)-50DP-0.4V(75)	CL684-6017-9-75	11.32	9.6	2.8	10.74	10.3	11.18
BM10B(0.8)-60DP-0.4V(75)	CL684-6001-9-75	13.32	11.6	3.2	12.74	12.3	13.18

3	リン青銅	△5	6	PS	プラスチックリール (BLACK)
2	リン青銅	△4	5	ポリエステル	CLEAR
1	LCP樹脂	UL94V-0, BLACK	4	PS	CLEAR
部番	材 質	処 理 , 備 考	部番	材 質	処 理 , 備 考
UNITS mm		SCALE 10 : 1	△の数 4	訂 正 記 事 DIS-H-005402	設 計 KR. AJITO
HRS HIROSE ELECTRIC CO., LTD.		承 認 : KH. IKEDA	08. 03. 17	図 番 : ADC3-317902-75	年 月 日 10. 12. 16
		検 図 : KY. MIDORIKAWA	08. 03. 17	製 品 名 : BM10B(0.8)-*DP-0.4V(75)	
		設 計 : TH. ARAI	08. 03. 16	製 品 コード	
		製 図 : SH. HOSODA	08. 03. 16	CL684-*****-75	△4 1/2

Apr. 1. 2024 Copyright 2024 HIROSE ELECTRIC CO., LTD. All Rights Reserved.
本製品を車載用途などの高い信頼性が求められる機器にご使用の場合は、弊社までお問合せ下さい。

